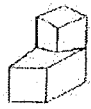
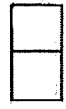


11201 PCB Layout 電腦繪圖(假日班)在職班招訓甄試 試題

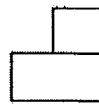
1. (2)



左圖的右側視圖是



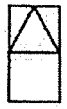
(2)



(3)



(4)



2. (1)

下列何者為發光二極體的符號



(2)



(3)

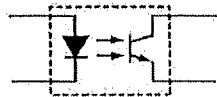


(4)



3. (2)

下圖符號為



(1) 橋式整流器

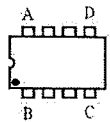
(2) 光耦合器

(3) 光電晶體

(4) 發光二極體

4. (2)

下圖 DIP IC 頂視圖，第一支接腳位置在



(1) C 腳

(2) B 腳

(3) A 腳

(4) D 腳

5. (3)

如圖電晶體零件的外型稱為



(1) TO5

(2) TO92

(3) TO220

(4) TO3

6. (3)

如圖電晶體零件的外型稱為



(1) TO5

(2) TO3

(3) TO92

(4) TO220

7. (1)

下圖符號為？



(1) 電感

(2) 電容

(3) 電阻

(4) 電磁線圈

8. (1)

下圖符號為？



(1) 保險絲

(2) 交流電壓源

(3) 指撥開關

(4) 直流電壓源

9. (2)

電容器串聯時可提高 (1) 電流容量 (2) 耐電壓值 (3) 頻率 (4) 電容量

11201 PCB Layout 電腦繪圖(假日班)在職班招訓甄試 試題

10. (1) 數位電路中，常在每個 IC 的電源附近並接一個電容器作為抗濾波干擾之用，其數值約 (1) $0.1\mu\text{F}$ (2) 1pF (3) $1000\mu\text{F}$ (4) 10pF
11. (1) 四層印刷電路板 (PCB) 結構中，VCC 和 GND 應在第幾層
(1) 2, 3 層 (2) 3, 4 層 (3) 1, 4 層 (4) 1, 2 層
12. (2) 常見的 PCB 材質為下列何者
(1) ABS (2) 玻璃纖維 (3) PVC (4) 紙漿
13. (3) 常見的 PCB 導電材質為下列何者
(1) 鐵 (2) 金 (3) 銅 (4) 銀
14. (4) 一般大容量的電容器多使用下列何者
(1) 麥拉電容 (2) 鉭質電容 (3) 陶瓷電容 (4) 電解電容
15. (3) 歐盟的 RoHS 標準在規範電子元件的
(1) 防火能力 (2) 幾何結構 (3) 有害成分 (4) 碳足跡
16. (2) 電子元件焊接時對於下列何者須考慮極性:
(1) 雲母電容器 (2) 電解電容器 (3) 陶質電容器 (4) 薄膜電容器
17. (1) 一般而言，下列何種元件沒有極性限制
(1) 電阻器 (2) 二極體 (3) 電解質電容器 (4) 變壓器
18. (1) 下列有關電子元件裝配的敘述，何者不正確？
(1) 發熱元件不需架高 (2) 元件裝置於電路板時，零件應由低至高依序裝
(3) 元件裝置的位置及方向要注意其標示數據必須以方便目視為原則
(4) 元件裝配注意不與相鄰元件短路

11201 PCB Layout 電腦繪圖(假日班)在職班招訓甄試 試題

19. (3) PCB 佈線 (Layout) 時，下列那一種線之銅箔最寬最粗？
(1) clock 線 (2) 位址線 (3) 電源線 (4) 資料線
20. (1) 表面黏著技術的電阻、電容尺寸規格下列何者為非？
(1) 1212 (2) 0201 (3) 0603 (4) 1206
21. (3) 下列何者非表面黏著技術元件特性
(1) 抗震能力強 (2) 重量輕 (3) 體積大 (4) 高頻特性好
22. (2) 下列何者封裝方式非表面黏著技術？
(1) TSOP (2) DIP (3) TQFP (4) SOT-223
23. (3) 零件包裝為 0805，下列何者不是它的特性？
(1) 兩鐸點之間的距離為 80mil (2) 為 50mil 方形的鐸點
(3) 為 5mil 方形的鐸點 (4) 是 SMT 零件
24. (2) 在雙面板 PCB 中，兩面的導線需相連時，必須要在兩面間有適當的電路連接才行。這種電路間的「橋樑」叫做
(1) 穿孔 (Throughholes) (2) 導孔 (via)
(3) 盲孔 (Blindvias) (4) 埋孔 (Buriedvias)
25. (2) 10mA 等於
(1) 0.001 安培 (2) 0.01 安培 (3) 0.1 安培 (4) 0.0001 安培